

中信证券股份有限公司

关于贵州振风光半导体股份有限公司

募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为贵州振风光半导体股份有限公司（以下简称“振风光”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司募投项目延期的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币66.99元。募集资金总额为人民币334,950.00万元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币325,992.36万元，其中超募金额为205,946.60万元。上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2022年8月23日出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第90043号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

（一）根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：元/人民币

序号	项目名称	总投资规模	本次拟使用募集资金金额
1	高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目	950,457,600.00	950,457,600.00
2	研发中心建设项目	250,000,000.00	250,000,000.00
合计		1,200,457,600.00	1,200,457,600.00

(二) 截至2025年11月30日，公司上述募投项目募集资金的具体使用情况如下：

单位：元/人民币

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金金额	原计划达到预定可使用状态日期	备注
1	高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目	950,457,600.00	39,402,308.90	2025.12.31	-
2	研发中心建设项目	250,000,000.00	169,836,416.45	2025.6.30	已结项
合计		1,200,457,600.00	209,238,725.35	-	-

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

(一) 募投项目延期情况

2024年3月13日，公司召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司“高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目”因不断深入论证项目方案、项目投资概算预增、自建厂房并进行适应性改造等因素影响，致使该募投项目实施进度有所延缓。公司将该项目达到预定可使用状态的日期调整为2025年12月31日。具体情况详见公司于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》。

现公司基于审慎性原则研究，结合当前公司募投项目实际进展情况，在实施主体、募集资金用途及投资项目规模均不发生变更的情况下，拟将募投项目全部达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	预计达到可使用状态日期	
		变更前	变更后
1	高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目	2025年12月31日	2027年12月31日

公司于2025年12月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目的建设期进行延长，计划于2027年12月31日前完成项目建设。

（二）本次高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目延期原因

本次募投项目延期是公司基于保障募集资金安全、提升资金使用效益，并积极应对外部环境变化的审慎决策。公司结合当前实际经营情况、国家宏观规划及下游客户需求变化，持续深化项目论证，对原建设进度进行调整。具体原因如下：

一方面，近年来集成电路产业链国产化步伐显著加快，核心制造设备与关键材料领域取得一系列技术突破，光刻机、金属镀膜设备以及光刻胶、抛光液等关键设备与材料已陆续进入国产化验证阶段。为积极响应国家产业链发展战略，并确保项目建设与供应链可控目标协调一致，振风光以高度审慎的态度，系统推进关键设备及原材料的国产化方案论证工作。相关选型与验证流程严格规范、环环相扣，一定程度上延长了项目前期准备周期。

另一方面，随着2025年“十五五”规划启动在即，国家对集成电路产业，特别是高可靠、高性能模拟集成电路在航天等高端领域的应用提出了更高标准。为精准匹配国家战略方向及前沿应用需求，公司秉持审慎原则，同步开展产品方案的深入调研与系统优化，重点针对模拟集成电路在航天等严苛环境下的可靠性、抗辐照等关键性能指标进行多轮论证与验证。为确保项目建设成果切实契合国家战略导向与高可靠市场发展趋势，振风光对项目方案进行了必要且细致的局部优化。目前，公司正与用户单位保持密切沟通，全面梳理应用需求，持续推进工艺平台与政策要求的适配性论证，力求以严谨、务实的态度保障项目成果符合国家战略与产业长期发展趋势，保障股东利益实现最大化。

四、项目继续实施的必要性及可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司对高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目的必要性及可行性进行了重新论证，认为该项目符合公司战略规划，项目继续实施仍具备必要性和可行性。

（一）项目实施的必要性

1、是突破发展瓶颈，向IDM模式转型的内在需求

振华风光作为高可靠模拟集成电路核心供应商，现有的Fabless模式难以实现设计与工艺的协同优化，制约了高端产品研发。转向IDM模式可打通设计、制造、封测环节，加速技术积累与产品迭代，是提升产品竞争力的必然选择。

2、是保障供应链安全，履行特殊使命的紧迫需求

国内现有特色模拟集成电路晶圆制造产能紧张，代工交期失控、成本飙升，公司已因此出现多款产品流片延期，影响了科研生产的配套交付。建设6英寸晶圆线是摆脱外部依赖、确保产品研制与按时交付的根本保障。

3、是拓展封装产品谱系，开拓广阔市场的战略需求

先进封测能力是高可靠产品做大做强的核心驱动力，突破传统封装限制，既能充分释放芯片设计潜力、巩固高可靠市场，更是振华风光进入民用市场、推动产品多样化发展，优化产业结构的关键支撑。

（二）项目实施的可行性

1、项目深度契合国家政策导向，为新兴领域发展提供坚实支撑

从政策与新兴领域来看，国家“十五五”规划建议明确提出，推动集成电路等重点领域关键核心技术取得决定性突破，为项目建设提供了强有力的战略导向与政策支持。同时，国家政策鼓励低空经济、商业航天、新能源等新兴领域发展，引导社会资本有序参与相关领域建设，而这些领域对模拟集成电路的需求呈现爆发式增长，无论是低空飞行器的控制、航空航天设备的环境感知，还是高端装备的信号处理，都离不开高可靠性、抗干扰、宽温区的模拟集成电路，且对产品的性能指标提出了更高要求。本项目针对性优化产品规划与工艺设计，深度契合上

述新兴领域的需求升级趋势，能够深度绑定高端应用市场，提升项目技术壁垒，保障项目长期盈利能力。

2、项目规划的工艺路线深度契合高端模拟集成电路的制造需求

从技术适配性来看，本项目规划的模拟集成电路晶圆制造工艺平台聚焦高速、高精度、抗辐照等方向，围绕车规级、宇航级等核心应用领域，涵盖了国际主流模拟集成电路工艺节点，契合当前国际主流发展趋势。该工艺路线兼具高可靠性、低功耗、成本可控等核心优势，既能满足汽车电子、工业控制等民用高端市场需求，又能匹配商业卫星、航空航天等场景的高可靠要求，技术路线成熟且市场适配性强。加之当前国产设备技术突破与产业链降价的双重机遇，项目投产后将凭借国产化成本优势与精准的市场定位，快速抢占进口替代市场份额，具备显著的经济效益与战略价值。

3、项目具有坚实的人才队伍支撑

公司储备了3名经验丰富的高层次领军人才，其中2人拥有超过30年的集成电路制造工艺开发经验，并曾参与多项国家重大项目建设，为技术发展奠定了坚实根基。在晶圆制造领域，公司组建了50余人的工程师团队，专业覆盖工艺整合、设备、厂务与质量管理全流程，团队中包括29名在国内知名晶圆产线工作10年以上的资深专家，以及20余名来自国内外知名半导体企业的技术骨干，实力雄厚。此外，封装测试团队以具备近20年行业经验的专家为核心，形成了19人的专业队伍，技术能力覆盖光刻、刻蚀、镀膜、植球等所有关键工序，能够为先进封装产线提供全面支持。

综上，目前振风光在人员储备、技术方案、工程建设等多方面已具备完整实施条件，项目延期是基于行业变化与长期发展的理性调整。后续公司将加快推进各项筹备工作，确保项目投产后快速实现盈利，为投资者带来持续稳定的回报。

（三）延期后按期完成的保障措施

为保障延期项目后续高效实施，公司将制定专项措施：一是成立高管牵头的工作组，建立快速决策与跨部门协调机制，确保项目组织有力；二是实施节点化精细管理，动态跟踪关键环节，全力保障进度受控；三是稳步推进供应链国产化，

通过专项验证确保设备材料可靠供应；四是持续对接用户与政策要求，动态优化方案，确保成果符合国家战略与高端市场需求；五是严格执行季度评估，全程监控资金与效益，确保项目目标达成与股东利益最大化。

（四）募集资金投资该项目的论证结论

综上所述，振风光继续开展高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目建设是必要且可行的。

五、募投项目延期对公司的影响

本次高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；项目延期未改变本项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对本项目的实施造成重大影响。本次延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

六、公司履行的审议程序

公司于2025年12月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目达到预定可使用状态时间延长两年，预计达到可使用状态日期为2027年12月31日，上述事项无需提交公司股东会审议。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目延期事项已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。该事项是根据募投项目的实际情况做出的决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于贵州振华风光半导体股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

马峥

石家峥

